

香港交易及结算有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二五年第四季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2026年2月12日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二五年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。

二零二五年第四季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入再创历史新高，达 6.599 亿美元，同比增长 22.4%，环比增长 3.9%。
- 毛利率 13.0%，同比上升 1.6 个百分点，环比下降 0.5 个百分点。
- 母公司拥有人应占利润 1,750 万美元，上年同期为亏损 2,520 万美元，上季度为利润 2,570 万美元。

二零二六年第一季度指引

- 我们预计销售收入约在 6.5 亿美元至 6.6 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 13%至 15%之间。

总裁致辞

公司董事会主席兼总裁白鹏博士对二零二五年第四季度及全年业绩评论道：

“华虹半导体二零二五年第四季度销售收入再创历史新高，达 6.599 亿美元，单季度毛利率为 13.0%，均符合指引预期。二零二五年全年，公司实现销售收入 24.021 亿美元，毛利率为 11.8%，同比均实现增长并符合管理层预期。在全球半导体市场受 AI 及其相关产品需求拉动、国内消费类需求回暖的背景下，公司产能维持高位运行，全年平均产能利用率为 106.1%，处于晶圆代工企业领先水平。”

白总继续表示：“通过优化产品组合及降本增效，公司各特色工艺平台均表现强劲，尤其是独立式闪存和电源管理平台，有力支撑了公司业绩增长与利润率上升。2025 年度，公司继续推进扩大产能的战略规划，无锡第二条 12 英寸产线（FAB9）一阶段产能建设超预期完成，上海 12 英寸制造基地（FAB5）收购事项有序推进。展望未来，公司将通过创新和快速代际迭代，持续高度聚焦于打造世界级特色工艺技术平台，并深化与国内外战略客户的合作。我们有信心在全球半导体产业变局中把握增长机遇，力争达到股东的长期期许。”

电话会议公告

日期 2026 年 2 月 12 日，星期四

时间： 17:00 香港/上海时间

04:00 美国东部时间

发言人： 白鹏，董事会主席兼总裁

王鼎，执行副总裁兼首席财务官

广播： 会议将在 https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/eicdo4wo> 作线上直播

(请提前注册登记)

电话直拨： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。

<https://register-conf.media-server.com/register/Blc6a59cc45c954742a912c5e8cd37e5a3>

重要提示：在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。

网上回放： 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先进 “特色 IC + Power Discrete” 的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有 “8 英寸 + 12 英寸” 先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂, 其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二五年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二五年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	659,882	539,177	635,180	22.4 %	3.9 %
毛利	85,464	61,426	85,854	39.1 %	(0.5)%
毛利率	13.0 %	11.4 %	13.5 %	1.6	(0.5)
经营开支	(130,165)	(110,626)	(100,433)	17.7 %	29.6 %
其他收入/(损失)净额	34,110	(40,468)	17,752	(184.3)%	92.1 %
税前(损失)/溢利	(10,591)	(89,668)	3,173	(88.2)%	(433.8)%
所得税开支	(8,069)	(6,596)	(10,363)	22.3 %	(22.1)%
期内损失	(18,660)	(96,264)	(7,190)	(80.6)%	159.5 %
净利润率	(2.8)%	(17.9)%	(1.1)%	15.1	(1.7)
以下各方应占:					
母公司拥有人	17,454	(25,199)	25,725	(169.3)%	(32.2)%
非控股权益	(36,114)	(71,065)	(32,915)	(49.2)%	9.7 %
持有人应占每股盈利					
基本	0.010	(0.015)	0.015	(166.7)%	(33.3)%
摊薄	0.010	(0.015)	0.015	(166.7)%	(33.3)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,448	1,213	1,400	19.4 %	3.4 %
产能利用率 ¹	103.8 %	103.2 %	109.5 %	0.6	(5.7)
净资产收益率 ²	1.2 %	(1.6)%	1.6 %	2.8	(0.4)

二零二五年第四季度

- 销售收入再创历史新高, 达 6.599 亿美元, 同比增长 22.4%, 环比增长 3.9%, 主要得益于付运晶圆数量上升及平均销售价格上涨。
- 毛利率 13.0%, 同比上升 1.6 个百分点, 主要得益于平均销售价格提升及降本增效; 环比下降 0.5 个百分点, 主要由于人工开支上升。
- 经营开支 1.302 亿美元, 同比上升 17.7%, 主要由于人工开支及折旧费用上升; 环比上升 29.6%, 主要由于人工开支上升。
- 其他收入净额 3,410 万美元, 上年同期为其他损失净额 4,050 万美元, 主要由于本期取得外币汇兑收益而上年同期为外币汇兑损失、财务费用下降及政府补贴上升; 环比上升 92.1%, 主要由于财务费用下降。
- 所得税开支 810 万美元, 同比上升 22.3%, 主要由于应课税利润增加。
- 期内损失 1,870 万美元, 同比减亏 80.6%, 环比增加亏损 159.5%。
- 母公司拥有人应占利润 1,750 万美元, 上年同期为亏损 2,520 万美元, 上季度为利润 2,570 万美元。
- 基本每股盈利 0.010 美元。
- 净资产收益率(年化) 1.2%。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二五年 (未经审核)	二零二四年 (已审核)	同比
销售收入	2,402,064	2,003,993	19.9 %
毛利	282,926	205,128	37.9 %
毛利率	11.8 %	10.2%	1.6
经营开支	(425,625)	(360,904)	17.9 %
其他收入净额	54,170	21,984	146.4 %
税前损失	(88,529)	(133,792)	(33.8)%
所得税开支	(22,284)	(6,593)	238.0 %
年内损失	(110,813)	(140,385)	(21.1)%
净利润率	(4.6)%	(7.0)%	2.4
以下各方应占:			
母公司拥有人	54,881	58,108	(5.6)%
非控股权益	(165,694)	(198,493)	(16.5)%
持有人应占每股盈利			
基本	0.032	0.034	(5.9)%
摊薄	0.032	0.034	(5.9)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	5,384	4,545	18.5 %
产能利用率	106.1 %	99.5 %	6.6
净资产收益率	0.9 %	0.9 %	-

二零二五年度

- 销售收入 24.021 亿美元, 较上年度上涨 19.9%, 主要得益于付运晶圆数量增加。
- 毛利率 11.8%, 较上年度上升 1.6 个百分点, 主要得益于平均销售价格提升及降本增效, 部分被折旧成本上升所抵消。
- 经营开支 4.256 亿美元, 较上年度上升 17.9%, 主要由于研发开支上升。
- 其他收入净额 5,420 万美元, 较上年度上升 146.4%, 主要由于财务费用及外币汇兑损失下降, 政府补贴上升, 部分被利息收入下降所抵消。
- 年内损失 1.108 亿美元, 较上年度减亏 21.1%。
- 母公司拥有人应占溢利 5,490 万美元, 较上年度小幅下降 5.6%。
- 基本每股盈利 0.032 美元。
- 净资产收益率 0.9%。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第四季度 % (未经审核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	634,431	96.1 %	512,677	95.1 %	121,754	23.7 %
其他	25,451	3.9 %	26,500	4.9 %	(1,049)	(4.0)%
销售收入总额	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

■ 本季度 96.1%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第四季度 % (未经审核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	252,846	38.3 %	252,234	46.8 %	612	0.2 %
12 吋晶圆	407,036	61.7 %	286,943	53.2 %	120,093	41.9 %
销售收入总额	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

■ 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.528 亿美元及 4.070 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第四季度 % (未经审核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	539,345	81.8 %	450,782	83.7 %	88,563	19.6 %
北美 ⁴	72,825	11.0 %	48,120	8.9 %	24,705	51.3 %
亚洲其他 ⁵	28,378	4.3 %	26,017	4.8 %	2,361	9.1 %
欧洲	19,334	2.9 %	14,258	2.6 %	5,076	35.6 %
销售收入总额	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度来自于中国的销售收入 5.393 亿美元，占销售收入总额的 81.8%，同比增长 19.6%，主要得益于其他电源管理、MCU、闪存及 CIS 产品的需求增加。
- 本季度来自于北美的销售收入 7,280 万美元，同比增长 51.3%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度来自于亚洲其他地区的销售收入 2,840 万美元，同比增长 9.1%。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,930 万美元，同比增长 35.6%，主要得益于 MCU 及 IGBT 产品的需求增加。

³包括中国大陆及中国香港。

⁴ 包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵ 包括中国台湾及日本。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第四季度 % (未经审核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	180,187	27.3 %	137,184	25.4 %	43,003	31.3 %
独立式非易失性存储器	56,610	8.6 %	46,056	8.5 %	10,554	22.9 %
功率器件	168,859	25.6 %	164,954	30.7 %	3,905	2.4 %
逻辑及射频	80,424	12.2 %	67,491	12.5 %	12,933	19.2 %
模拟与电源管理	173,802	26.3 %	123,492	22.9 %	50,310	40.7 %
销售收入总额	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.802 亿美元，同比增长 31.3%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 5,660 万美元，同比增长 22.9%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- 本季度功率器件销售收入 1.689 亿美元，同比增长 2.4%，主要得益于通用 MOSFET 产品需求增加。
- 本季度逻辑及射频销售收入 8,040 万美元，同比增长 19.2%，主要得益于 CIS 产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.738 亿美元，同比增长 40.7%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第四季度 % (未经审核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	186,687	28.3 %	129,033	23.9 %	57,654	44.7 %
90nm 及 95nm	163,929	24.8 %	106,414	19.7 %	57,515	54.0 %
0.11μm 及 0.13μm	69,767	10.6 %	70,233	13.0 %	(466)	(0.7)%
0.15μm 及 0.18μm	33,543	5.1 %	31,328	5.8 %	2,215	7.1 %
0.25μm	1,852	0.3 %	2,724	0.5 %	(872)	(32.0)%
0.35μm 及以上	204,104	30.9 %	199,445	37.1 %	4,659	2.3 %
销售收入总额	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度 65nm 及以下工艺技术节点的销售收入 1.867 亿美元，同比增长 44.7%，主要得益于其他电源管理、闪存、MCU、CIS、逻辑及 RF 产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 1.639 亿美元，同比增长 54.0%，主要得益于其他电源管理、MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工艺技术节点的销售收入 6,980 万美元，同比持平。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工艺技术节点的销售收入 3,350 万美元，同比增长 7.1%，主要得益于 MCU 及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度 0.25μm 工艺技术节点的销售收入 190 万美元，同比下降 32.0%，主要由于功率器件产品的需求下降。
- 本季度 0.35μm 及以上工艺技术节点的销售收入 2.041 亿美元，同比增长 2.3%，主要得益于通用 MOSFET 产品的需求增加。

销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二五年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第四季度 % (未经审核)	二零二四年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
消费电子	419,635	63.7 %	344,594	63.9 %	75,041	21.8 %
工业及汽车	146,724	22.2 %	124,037	23.0 %	22,687	18.3 %
通信	83,454	12.6 %	64,619	12.0 %	18,835	29.1 %
计算	10,069	1.5 %	5,927	1.1 %	4,142	69.9 %
销售收入总额	659,882	100.0 %	539,177	100.0 %	120,705	22.4 %

- 本季度消费电子作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 4.196 亿美元，占销售收入总额的 63.7%，同比增长 21.8%，主要得益于其他电源管理、MCU 及闪存产品的需求增加。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.467 亿美元，同比增长 18.3%，主要得益于其他电源管理及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度通信类产品销售收入 8,350 万美元，同比增长 29.1%，主要得益于 CIS、RF、智能卡芯片及模拟产品的需求增加。
- 本季度计算类产品销售收入 1,010 万美元，同比增长 69.9%，主要得益于通用 MOSFET 及 MCU 产品的需求增加。

产能⁶及产能利用率

	二零二五年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二五年 第三季度 (未经审核)
总产能(折合 8 吋千片晶圆)	486	391	468
总体产能利用率	103.8%	103.2%	109.5%

- 本季度末月产能 486,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 103.8%。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二五年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二五年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,448	1,213	1,400	19.4 %	3.4 %

- 本季度付运晶圆 1,448,000 片，同比上升 19.4%，环比上升 3.4%。

⁶ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

经营开支分析

以千美元计	二零二五年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二五年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	3,791	2,617	2,332	44.9 %	62.6 %
管理费用 ⁷	126,374	108,009	98,101	17.0 %	28.8 %
经营开支	130,165	110,626	100,433	17.7 %	29.6 %

- 经营开支 1.302 亿美元，同比上升 17.7%，主要由于人工开支及折旧费用上升；环比上升 29.6%，主要由于人工开支上升。

其他收入/(损失)净额

以千美元计	二零二五年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二五年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,932	3,481	3,625	13.0 %	8.5 %
利息收入	15,228	20,450	13,762	(25.5)%	10.7 %
汇兑收入/(损失)	7,014	(48,664)	3,746	(114.4)%	87.2 %
分占联营公司溢利/(损失)	1,261	(433)	1,843	(391.2)%	(31.6)%
财务费用	(8,414)	(20,406)	(18,249)	(58.8)%	(53.9)%
政府补贴	16,280	4,705	12,741	246.0 %	27.8 %
其他	(1,191)	399	284	(398.5)%	(519.4)%
其他收入净额	34,110	(40,468)	17,752	(184.3)%	92.1 %

- 其他收入净额 3,410 万美元，上年同期为其他损失净额 4,050 万美元，主要由于本期取得外币汇兑收益而上年同期为外币汇兑损失、财务费用下降及政府补贴上升；环比上升 92.1%，主要由于财务费用下降。

⁷管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二五年 第四季度 (未经审核)	二零二四年 第四季度 (未经审核)	二零二五年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	246,026	348,783	184,150	(29.5)%	33.6 %
投资活动所用现金流量净额	(585,659)	(1,484,688)	(253,296)	(60.6)%	131.2 %
融资活动所得/(用)现金流量净额	1,361,101	(50,929)	104,163	(2,772.5)%	1,206.7 %
外汇汇率变动影响净额	34,759	(120,783)	22,816	(128.8)%	52.3 %
现金及现金等价物变动影响净额	1,056,227	(1,307,617)	57,833	(180.8)%	1,726.3 %

- 本季度经营活动所得现金流量净额 2.460 亿美元，同比下降 29.5%，主要由于向供应商支付货款增加及收到的政府补贴下降，部分被客户收款上升所抵消；环比上升 33.6%，主要由于收到的政府补贴上升。
- 投资活动所用现金流量净额 5.857 亿美元，其中包括固定资产投资支出 6.335 亿美元，及其他权益工具投资 360 万美元，部分被收到政府对设备的补助 3,660 万美元，利息收入 1,360 万美元及设备处置款 120 万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额 13.611 亿美元，其中提取银行借款 9.190 亿美元，其他融资活动收到的现金 5.946 亿美元，政府对财务费用的补助 1,210 万美元及员工行权发行股份收到 470 万美元，部分被偿还银行借款 1.361 亿美元，支付利息 3,280 万美元及支付租赁负债 40 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于十二月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)
资产总额	14,453,772	12,511,666
负债总额	5,289,541	3,502,618
所有者权益总额	9,164,231	9,009,048
资产负债率 ⁸	36.6%	28.0%

资本开支

以千美元计	二零二五年 第四季度 (未经审核)	二零二五年 第三季度 (未经审核)
华虹 8 吋	74,527	19,305
华虹 12 吋	558,956	242,589
合计	633,483	261,894

- 本季度资本开支 6.335 亿美元，其中 5.590 亿美元用于华虹 12 吋，7,450 万美元用于华虹 8 吋。

⁸资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于十二月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)
已竣工待售物业	215,511	223,302
存货	544,368	526,840
贸易应收款项及应收票据	282,053	257,067
预付款项、其他应收款项及其他资产	561,328	494,222
应收关联方款项	10,135	22,150
已冻结存款及定期存款	32,342	31,993
现金及现金等价物	4,960,960	3,904,733
流动资产总额	6,606,697	5,460,307
贸易应付款项	330,370	275,064
其他应付款项及暂估费用	1,008,586	704,754
计息银行借款	403,748	340,686
租赁负债	3,229	3,598
政府补助	89,049	66,498
应付关联方款项	6,225	7,832
应付所得税	15,014	14,341
流动负债总额	1,856,221	1,412,773
净营运资金	4,750,476	4,047,534
速动比率	3.1x	3.3x
流动比率	3.6x	3.9x
贸易应收款项及应收票据周转天数	37	37
存货周转天数	83	85

- 贸易应收款项及应收票据由上季度末的 2.571 亿美元上升至本季度末的 2.821 亿美元，主要由于销售收入增加。
- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 4.942 亿美元上升至本季度末的 5.613 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 应收关联方款项由上季度末的 2,220 万美元下降至本季度末的 1,010 万美元，主要由于本季度收到一家关联方的租金款。
- 贸易应付款项由上季度末的 2.751 亿美元上升至本季度末的 3.304 亿美元，主要由于采购额增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 7.048 亿美元上升至本季度末的 10.086 亿美元，主要由于本季度应付资本开支上升。
- 计息银行借款由上季度末的 3.407 亿美元上升至本季度末的 4.037 亿美元，主要由于长期银行借款的一年内到期部分增加。
- 政府补助由上季度末的 6,650 万美元上升至本季度末的 8,900 万美元，主要由于本季度收到的政府补助增加。
- 净营运资金 本季度末 47.505 亿美元，流动比率 3.6。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 37 天。
- 存货周转天数 83 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于十二月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二四年 (未经审核)	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)
销售收入	659,882	539,177	635,180
销售成本	(574,418)	(477,751)	(549,326)
毛利	85,464	61,426	85,854
其他收入及收益	44,107	29,155	34,361
投资物业的公平值损失	(2,844)	(39)	
销售及分销费用	(3,791)	(2,617)	(2,332)
管理费用	(126,374)	(108,009)	(98,101)
其他费用	-	(48,745)	(203)
财务费用	(8,414)	(20,406)	(18,249)
分占联营公司溢利/(损失)	1,261	(433)	1,843
税前(损失)/溢利	(10,591)	(89,668)	3,173
所得税开支	(8,069)	(6,596)	(10,363)
期内损失	(18,660)	(96,264)	(7,190)
以下各方应占：			
母公司拥有人	17,454	(25,199)	25,725
非控股权益	(36,114)	(71,065)	(32,915)
持有人应占每股盈利			
基本	0.010	(0.015)	0.015
摊薄	0.010	(0.015)	0.015
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,736,132,077	1,718,222,223	1,731,461,953
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,736,269,454	1,724,086,667	1,733,014,365

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	二零二五年 (未经审核)	二零二四年 (已审核)
销售收入	2,402,064	2,003,993
销售成本	(2,119,138)	(1,798,865)
毛利	282,926	205,128
其他收入及收益	127,408	149,072
投资物业的公平值损失	(2,844)	(39)
销售及分销费用	(10,967)	(9,628)
管理费用	(414,658)	(351,276)
其他费用	(6,527)	(33,395)
财务费用	(68,214)	(97,113)
分占联营公司溢利	4,347	3,459
税前损失	(88,529)	(133,792)
所得税开支	(22,284)	(6,593)
期内损失	(110,813)	(140,385)
以下各方应占：		
母公司拥有人	54,881	58,108
非控股权益	(165,694)	(198,493)
持有人应占每股盈利		
基本	0.032	0.034
摊薄	0.032	0.034
用于计算持有人应占每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数	1,728,942,231	1,717,346,778
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数	1,729,052,605	1,721,085,846

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于十二月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二四年 (已审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	6,676,442	6,162,217	5,859,117
投资物业	219,772	220,223	164,153
使用权资产	64,482	65,141	77,761
无形资产	35,509	33,982	31,456
于联营公司的投资	150,222	147,349	139,799
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	478,799	381,305	289,311
长期预付款项	221,849	41,142	21,008
非流动资产总额	7,847,075	7,051,359	6,582,605
流动资产			
已竣工待售物业	215,511	223,302	221,905
存货	544,368	526,840	467,060
贸易应收款项及应收票据	282,053	257,067	270,461
预付款项、其他应收款项及其他资产	561,328	494,222	363,997
应收关联方款项	10,135	22,150	18,324
已冻结存款及定期存款	32,342	31,993	31,624
现金及现金等价物	4,960,960	3,904,733	4,459,132
流动资产总额	6,606,697	5,460,307	5,832,503
流动负债			
贸易应付款项	330,370	275,064	298,372
其他应付款项及暂估费用	1,008,586	704,754	880,447
计息银行借款	403,748	340,686	280,704
租赁负债	3,229	3,598	4,912
政府补助	89,049	66,498	57,563
应付关联方款项	6,225	7,832	9,125
应付所得税	15,014	14,341	31,115
流动负债总额	1,856,221	1,412,773	1,562,238
流动资产净额	4,750,476	4,047,534	4,270,265
总资产减流动负债	12,597,551	11,098,893	10,852,870
非流动负债			
计息银行借款	2,787,096	2,056,802	1,917,235
租赁负债	15,679	15,329	18,068
递延税项负债	35,964	17,714	10,948
其他非流动负债	594,581	-	-
非流动负债总额	3,433,320	2,089,845	1,946,251
净资产	9,164,231	9,009,048	8,906,619
权益和负债权益			
股本	4,987,482	4,982,556	4,938,457
储备	1,625,181	1,466,529	1,308,569
本公司拥有人应占权益	6,612,663	6,449,085	6,247,026
非控股权益	2,551,568	2,559,963	2,659,593
权益总额	9,164,231	9,009,048	8,906,619

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于十二月三十一日	于十二月三十一日	于九月三十日
	二零二五年 (未经审核)	二零二四年 (未经审核)	二零二五年 (未经审核)
经营活动现金流量：			
税前(亏损)/溢利	(10,591)	(89,668)	3,173
折旧及摊销	195,876	142,306	187,269
应占联营公司(溢利)/损失	(1,261)	433	(1,843)
营运资金的变动及其它	62,002	295,712	(4,449)
经营活动所得现金流量净额	246,026	348,783	184,150
投资活动现金流量：			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(633,483)	(1,546,384)	(261,894)
投资其他权益工具	(3,557)	-	(14,030)
收到政府对设备的补助	36,596	41,149	-
其他投资活动所得现金流量	14,785	20,547	22,628
投资活动所用现金流量净额	(585,659)	(1,484,688)	(253,296)
融资活动现金流量：			
提取银行贷款	919,025	84,551	99,923
发行股份所得收益	4,740	1,478	14,376
偿还银行贷款	(136,107)	(91,518)	(3,284)
已付利息	(32,834)	(50,498)	(4,971)
支付租赁负债	(428)	(401)	(1,881)
收到政府对财务费用的补助	12,124	5,459	-
其他融资活动收到的现金	594,581	-	-
融资活动所得/(用)现金流量净额	1,361,101	(50,929)	104,163
现金及现金等价物增加/(减少)净额	1,021,468	(1,186,834)	35,017
期初现金及现金等价物	3,904,733	5,766,749	3,846,900
外汇汇率变动影响净额	34,759	(120,783)	22,816
期末现金及现金等价物	4,960,960	4,459,132	3,904,733

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	二零二五年 (未经审核)	二零二四年 (已审核)
经营活动现金流量：		
税前亏损	(88,529)	(133,792)
折旧及摊销	734,928	555,832
应占联营公司溢利	(4,347)	(3,459)
营运资金的变动及其它	7,940	40,914
经营活动所得现金流量净额	649,992	459,495
投资活动现金流量：		
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(1,813,956)	(2,779,857)
购买其他权益工具	(17,587)	(17,618)
投资联营企业	(2,794)	-
收到政府对设备的补助	49,186	41,149
其他投资活动所得现金流量	66,349	84,794
投资活动所用现金流量净额	(1,718,802)	(2,671,532)
融资活动现金流量：		
发行股份所得收益	34,411	3,642
非控股权益资本注资	-	1,181,880
提取银行贷款	2,018,029	289,285
偿还银行贷款	(1,076,224)	(183,524)
已付利息	(79,680)	(105,736)
向股东支付股息	-	(36,247)
收到政府对财务费用的补助	12,124	5,459
支付租赁负债	(4,025)	(4,634)
其他融资活动收到的现金	594,581	-
融资活动所得现金流量净额	1,499,216	1,150,125
现金及现金等价物增加/(减少)净额	430,406	(1,061,912)
期初现金及现金等价物	4,459,132	5,585,181
外汇汇率变动影响净额	71,422	(64,137)
期末现金及现金等价物	4,960,960	4,459,132

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

白鹏(董事长兼总裁)

非执行董事

叶峻

孙国栋

陈博

熊承艳

独立非执行董事

张祖同

王桂壘太平绅士

封松林

承董事会命

华虹半导体有限公司

白鹏

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二六年二月十二日